

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1、基本情况

2021年7月2日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在全资子公司捷捷半导体有限公司建设“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”，总投资5.1亿元人民币；资金来源：捷捷半导体有限公司自有资金；项目总规划用地约56亩。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目实施方情况

- （1）公司名称：捷捷半导体有限公司
- （2）统一社会信用代码：91320691314159305G
- （3）住所：南通市苏通科技产业园井冈山路6号

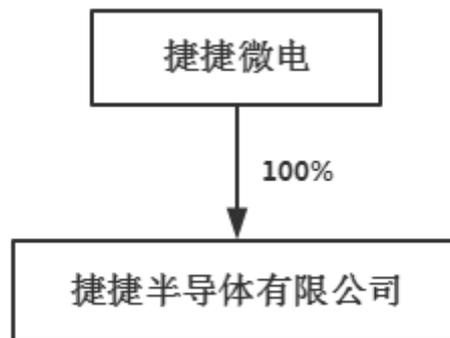
(4) 法定代表人：黎重林

(5) 成立日期：2014年09月28日

(6) 注册资本：42000万元人民币

(7) 经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路设计、制造、销售、产品研发及技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 股权结构：公司持有100%的股权。



(9) 捷捷半导体的主要财务数据

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额 (元)	918,819,718.92	971,286,669.70
负债总额 (元)	144,657,782.10	148,459,944.38
净资产 (元)	774,161,936.82	822,826,725.32
项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
营业收入 (元)	372,318,813.37	131,779,577.21
利润总额 (元)	130,722,703.35	53,829,640.99
净利润 (元)	113,097,974.69	45,755,194.85

(10) 捷捷半导体有限公司非失信被执行人。

(二) 对外投资的主要内容

项目名称：功率半导体 6 英寸晶圆及器件封测生产线建设项目

项目内容：本项目计划采用深 Trench 刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺。主要产品为快恢复二极管芯片及器件，IGBT 模块配套用高电压大通流整流芯片，低电容、低残压等保护器件芯片及器件，中高电压功率集成芯片，平面可控硅芯片及其他芯片产品等。

行业类型：半导体电子产业

项目投资：拟总投资 5.1 亿元人民币（分二期），其中，固定资产投资不低于总投资的 80%，设备投入不低于固定资产投资的 50%（包括净化成套装置）。

项目实施方式：由全资子公司捷捷半导体有限公司实施。

项目资金来源：为捷捷半导体有限公司自有资金。

项目选址：苏锡通科技产业园井冈山 6 号（全资子公司捷捷半导体有限公司），占地面积约 56 亩（现有地块）。

四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

公司此次对外投资是公司的战略需要，继续深耕功率半导体产业应用领域，进一步拓展公司产品结构符合产业结构之需要，提升公司产能与市场份额，有利于提升公司功率半导体进口替代能力和持续经营能力、综合实力及竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

（二）存在风险

1、本次对外投资资金来源于捷捷半导体有限公司自有资金，若本次投资未达到预期，将对捷捷半导体有限公司的现金使用效率产生一定影响。

2、投资周期风险。从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节较多，如投资管理不善，突破预算等原因，可能会导致投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，影响整个项目的实施规划。

本次对外投资事项以捷捷半导体有限公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2021年7月2日